

Hochschule Aalen

Prof. Dr. Bürkle, 07361 576-2103
E-Mail: heinz-peter.buerkle@htw-aalen.de

Hochschule Albstadt-Sigmaringen

Prof. Dr. Gerlach, 07431 732-9155
E-Mail: gerlach@hs-albsig.de

Hochschule Esslingen

Prof. Dr. Lindermeir, 0711 397-4230
E-Mail: walter.lindermeir@hs-esslingen.de

Hochschule Furtwangen

Prof. Dr. Rülling, 07723 920-2503
E-Mail: ruelling@hs-furtwangen.de

Hochschule Heilbronn

Prof. Dr. Gessler, 07940 1306-184
E-Mail: gessler@hs-heilbronn.de

Hochschule Karlsruhe

Prof. Dr. Ihle, 0721 925 - 1571
E-Mail: marc.ihle@hs-karlsruhe.de

Hochschule Konstanz

Prof. Dr. Schick, 07531 206-657
E-Mail: cschick@htwg-konstanz.de

Hochschule Mannheim

Prof. Dr. Giehl, 0621 292-6860
E-Mail: j.giehl@hs-mannheim.de

Hochschule Offenburg

Prof. Dr. Mackensen, 0781 205-4770
E-Mail: elke.mackensen@hs-offenburg.de

Hochschule Pforzheim

Prof. Dr. Kesel, 07231 28-6567
E-Mail: frank.kesel@hs-pforzheim.de

Hochschule Ravensburg-Weingarten

Prof. Dr. Ludescher, 0751 501-9685
E-Mail: ludescher@hs-weingarten.de

Hochschule Reutlingen

Prof. Dr. Hennig, 07121 271-7129
E-Mail: eckhard.hennig@reutlingen-university.de

Hochschule Ulm

Prof. Dr. Terzis, 0731 502-8341
E-Mail: terzis@hs-ulm.de

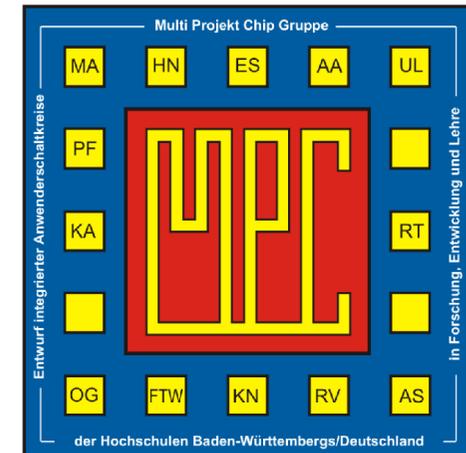
Gerne erörtern wir mit Ihnen Wege der Zusammenarbeit.

Für den Erstkontakt wenden Sie sich bitte an Ihren MPC-Ansprechpartner am nächstgelegenen Hochschulort.

Sie finden uns auch im Internet unter <http://www.mpc.belwue.de>



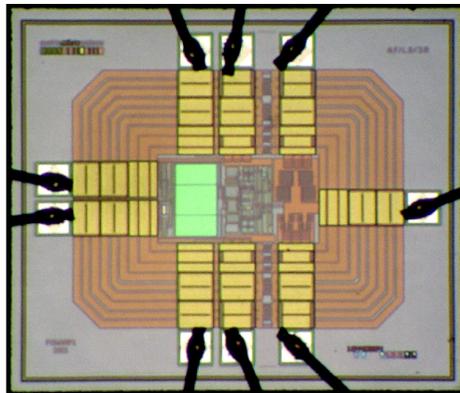
Hochschulen
in
Baden-Württemberg



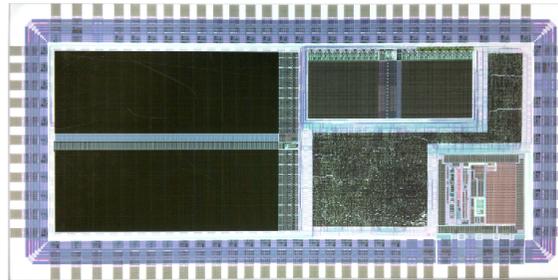
**Multi Projekt Chip
Gruppe**

**Ihr Partner bei der Entwicklung
integrierter Schaltungen**

Die Multi Projekt Chip Gruppe (MPC-Gruppe) ist eine Kooperation, an der sich rund 50 Professoren aus 13 baden-württembergischen Hochschulen beteiligen. Gemeinsam ist uns, dass wir alle das Spezialgebiet *Entwurf und Test monolithisch integrierter Schaltungen* vertreten. Wir vermitteln jährlich ca. 600 künftigen Ingenieuren Grundkenntnisse auf dem Gebiet der Schaltungsintegration. Ferner ebnen wir mit etwa 100 Bachelor-/Masterarbeiten pro Jahr vielen Unternehmen den Weg für spätere Produkte mit hoch integrierten Bausteinen.



Rail-to-Rail-Operationsverstärker in AMS C35B4C3 0,35 μm CMOS 4M/2P/HR, Abmessung 1,19 mm x 1,00 mm, Entwurf Lukas Summ u.a., Hochschule Ulm



Plot der Strukturen des ASIC-PDA V2, in einer UMC 0.18 μm CMOS 1P6M-Technologie, Abmessung des Chips 1,52 x 3,16 mm², 241 MIPS, Entwurf Benjamin Dusch u. a., Hochschule Offenburg

Im Rahmen des Wissens- und Technologietransfers können wir für Unternehmen noch mehr tun und bieten unsere Hilfe bei der Entwicklung von ASIC's an:

- Beratung bei der Auswahl der geeigneten Integrationsform und Technologie
- Hilfe bei der Entwicklung von Entwurfsbaukästen und Bibliotheken
- Entwurf Ihrer integrierten Schaltungen sowie Beschaffung, Analyse und Spezifikation der Musterschaltungen
- Weiterbildung Ihrer Mitarbeiter

Wir benutzen Technologien und Bibliotheken bekannter Halbleiterhersteller und sind in der Lage, über EURORACTICE und CMP Muster in den nachstehenden Technologien zu vorteilhaften Konditionen fertigen zu lassen:

- AMS Austria Microsystems 0.35 μm und 0.5 μm CMOS Standardzellen (analog/digital) und Full Custom
- ON-Semiconductors 0.35 und 0.5 μm CMOS A/D Standardzellen und Full Custom
- TSMC 0.18 μm und 0.25 μm CMOS-Standardzellen
- UMC 0.25 μm , 0.18 μm , 0.13 μm , 90 nm und 65 nm Standardzellen und Full Custom
- Alle über Europractice und CMP erhältlichen Technologien
- FPGA-Designs für XILINX und ALTERA, GATE ARRAY Technologien div. Anbieter
- IP-Entwicklung (analog/digital) und Portierung auf Zieltechnologien